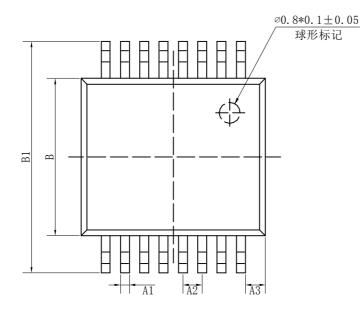
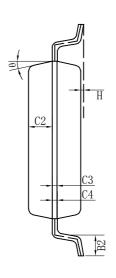
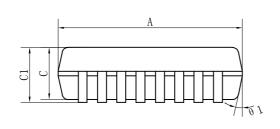


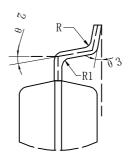
气源科核股份有限公司 China Chippacking Technology Co., Ltd

标注	最小(mm)	最大(mm)	标注	最小(mm)	最大(mm)			
A	6. 15	6. 25	C3	0. 152				
A1	0.3	OTYP	C4	0. 172				
A2	0.6	5TYP	Н	0.05	0. 15			
A3	0.6	75TYP	θ	12° TYP4 12° TYP4				
В	5. 25	5. 35	θ 1					
B1	B1 7. 65 7. 95 B2 0. 60 0. 80		θ 2	10° TYP 0° ∼ 8°				
B2			θ 3					
С	1.70	1. 80	R	0. 20TYP				
C1	1. 75	1. 95	R1	0. 15TYP				
C2	0.7	99						









_								_			
制	图	石	艳	2016. 02. 01	名	称	生效日	期			
审	核				SSOP16 (0. 65)		等级标记		重量	比例	
批	准				封装产	品图					
单	位	mm		图	号	页 数 第		1页 共1页			
镀	涂				C-0L-025		气派科技股份有限公司				
			•		版次 B		CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd				

未注尺寸公差
×± 0.5
×.×±0.1
×.××±0.01
×.×××±0.005